

先孔工法対応

ポリイミドフィルムへのニッケルシード層形成プロセス

Applicable to Polyimide Film with Hole
Nickel Seed Layer Forming Process on Polyimide Film

トップSAPINAプロセス

TOP SAPINA PROCESS

- 全工程湿式プロセスであり、Roll to Roll処理により両面を一括でメタライズ可能
All steps : Wet process Metallizing both sides at once by Roll to Roll treatment
- 金属濃度の低下による低コスト化を実現
Low metal concentration, effective in cost reduction
- パラジウム吸着量の制御による優れたパターン性
Great fine patterning performance by controlling Pd adsorption amount
- 先孔工法に対応
Applicable to polyimide film with hole

処理工程 Proces



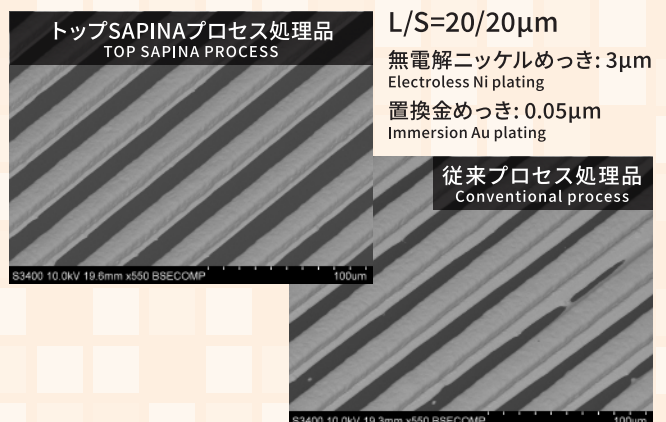
低いパラジウム濃度 Low Pd concentration

	カタリスト浴中のパラジウム濃度 Pd concentration in catalyzing bath	パラジウム吸着量 Pd adsorption amount
トップSAPINAプロセス (アルカリイオンタイプ) TOP SAPINA PROCESS (Alkaline ion type)	105mg/L	17 μ g/dm ²
従来プロセス (酸性コロイドタイプ) Conventional process (Acid colloid type)	190mg/L	30 μ g/dm ²

パラジウム濃度が低く、低コストなプロセス
Low Pd concentration, cost-effective process

優れたファインパターン性

Excellent in fine patterning performance



パラジウム吸着量が少なく
ニッケル/金めっき時のパターン性に優れる
Great fine pattern ability of Ni/Au plating
Because of low Pd adsorption amount

経時安定性に優れる密着強度

Great adhesion and stability after aging

